

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 25 年 5 月 30 日 (2013.5.30)

【公開番号】特開 2012-151482 (P2012-151482A)

【公開日】平成 24 年 8 月 9 日 (2012.8.9)

【年通号数】公開・登録公報 2012-031

【出願番号】特願 2012-48500 (P2012-48500)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

C 2 3 C 16/455 (2006.01)

C 2 3 C 16/509 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 B

H 0 5 H 1/46 M

C 2 3 C 16/455

C 2 3 C 16/509

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 3 月 23 日 (2012.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を支持するように構成された下部電極の反対側に配置された上部電極を含むプラズマ処理チャンバにおけるガスフローコンダクタンスを制御するための装置であって、

前記下部電極を同心円状に取り囲むように構成され、内部に形成された第 1 のスロットセットを含むグランドリングと、

内部に形成された第 2 のスロットセットを含む静止したカバーリングと、

前記グランドリングと前記カバーリングとの間に配置され、内部に形成された第 3 のスロットセットを含むバイパスチョークリングと、

( i ) ガスが前記第 1、第 2、および、第 3 のスロットセットを通して流れることができるように、前記第 1 のスロットセットが、前記第 3 のスロットセットと流体連結されたオン状態と、( i i ) ガスが前記第 1、第 2、第 3 のスロットセットを通して流れることができないように、前記第 1 のスロットセットが、前記バイパスチョークリングによって遮られるオフ状態との間で、前記第 1、第 2、および、第 3 のスロットセットを通してガスフローコンダクタンスを制御するために、前記第 1 と第 3 のスロットセットの間での重なり量を変えるために、前記グランドリングに相対して前記バイパスチョークリングを回転するように構成された機構と、を含む装置。